

HONDA et al.
U.S. Serial No. 09/678,609
Our Ref. No. 8013-1147

Remarks:

The applicant, in the Opinion Document submitted along with the Amendment document, asserts that the invention of the present application differs from the priority Citation 1 in the point that a columnar electro-conductive body is electrically connected to an external electrode pad.

However, since lead 3 recorded in the previous Citation 1 also has thickness, its columnar shape is recognized. Also, the question of how to connect a columnar electrode to an external connection pad is nothing more than a simple matter of design.

In addition, the invention of the present application asserts that it is different from Citation 2 in the point of directly forming an external electrode pad on a metallic substrate.

However, the direct formation of an external electrode on a metallic substrate is known technology (reference is made, for example, to Japanese Laid Open Patent Publication Hei 10-125818), and even in the invention recorded in priority Citation 2, the adoption of known technology is recognized as something which could be appropriately obtained by one skilled in the Art.

Hence, despite the assertion of the applicant, the previous grounds for rejection are not withdrawn.

拒絶査定

特許出願の番号	特願 2 0 0 0 - 0 5 7 7 6 7
起案日	平成 1 6 年 8 月 1 7 日
特許庁審査官	坂本 薫昭 9 2 6 5 4 R 0 0
発明の名称	半導体装置、配線基板、及び、それらの製造方法
特許出願人	N E C エレクトロニクス株式会社
代理人	工藤 実

この出願については、平成 1 6 年 2 月 2 4 日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものである。

なお、意見書並びに手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。

備考

出願人は補正書とともに提出された意見書において、本願発明は、柱状の導電体を外部電極パッドに電氣的に接続している点で、先の引用例 1 とは相違するとも主張している。

しかしながら、先の引用例 1 に記載されたリード 3 も、厚さを有しているため、柱状と認められる。そして、柱状の電極をどのように外部接続パッドと接続するかは、単なる設計事項にすぎない。

また、本願発明は、金属基板上に、直接、外部電極パッドを形成する点で、先の引用例 2 とは相違する旨主張している。

しかしながら、金属基板上に、直接、外部電極パッドを形成することは、周知技術であり（例えば、特開平 1 0 - 1 2 5 8 1 8 号公報）、先の引用例 2 に記載された発明においても、上記周知技術を採用することは、当業者が適宜なし得たものと認められる。

よって、出願人の主張に拘らず、先の拒絶理由は撤回しない。

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。

認証日 平成16年 8月18日 経済産業事務官 高渕 清士